

# TLF 801 17 昆山锐钠德电子

产品名称	TLF 801 17 昆山锐钠德电子
公司名称	昆山锐钠德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市登云路268号
联系电话	15051633317

## 产品详情

昆山锐钠德电子科技有限公司是一家专业的电子辅料及工业自动化解决方案的国家高新技术企业。经过十多年的不断开拓和发展，现在已经成为国内焊锡行业最知名的生产供应商之一。

### 工厂实施无铅焊接的注意事项

#### 其它因素

被动元件的立碑效应是铅锡焊接过程中经常需要考虑的问题，无铅焊锡更高的熔点及更大的表面张力将使这一问题更加严重。锡膏在被动元件的一端比另一端先融化是此不良产生的主要原因，另外，线路板焊盘上锡膏过多以及元件贴装不对称也会导致立碑。可能因为有沉埋孔的焊盘升温更快，当被动元件焊盘处在沉埋孔上时立碑效应特别明显，原因是沉埋孔上的焊盘热容量低导致升温非常快。

昆山锐钠德电子科技有限公司是一家专业的电子辅料及工业自动化解决方案的国家高新技术企业。经过十多年的不断开拓和发展，现在已经成为国内焊锡行业最知名的生产供应商之一。

### 未来助焊剂的发展趋势

关于未来助焊剂的发展趋势，用两个字来归纳其中心思想就是——“环保”。免清洗助焊剂的展开其实也是环保的趋动，从焊后板面较多的松香残留，到焊后用溶剂清洗，然后再到免清洗就是一个日益环保的展开进程，水洗助焊剂只不过是展开到了溶剂清洗过程中的一个产品罢了。

昆山锐钠德电子科技有限公司是一家专业的电子辅料及工业自动化解决方案的国家高新技术企业。经过十多年的不断开拓和发展，现在已经成为国内焊锡行业最知名的生产供应商之一。

### 工厂实施无铅焊接的注意事项

无铅焊接会引起一个新的潜在空洞产生源，TLF-801-17，即某些BGA只有铅锡焊球。当使用无铅锡膏及铅锡凸点BGA时，焊锡球会在比锡膏熔点低35 处熔化。在焊锡球是液态而锡膏不是液态时，助焊剂会放出气体直接进入熔化的锡球中，从而可能产生大量的空洞。有人做过一项DOE试验来确定回流温度曲线温升速率对空洞产生数量及大小的影响，使用的温升速率为0.5、0.8和1.5 /秒，试验结果表明较高的温升速率能显著地减少所产生空洞的大小。

TLF-801-17-昆山锐纳德电子由昆山锐纳德电子科技有限公司提供。“电子产品、机械设备、非标自动化设备”就选昆山锐纳德电子科技有限公司（[www.ksrnd.cn](http://www.ksrnd.cn)），公司位于：昆山市登云路268号，多年来，昆山锐纳德坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山锐纳德期待成为您的长期合作伙伴！